

【目的】

本研究会は、筑波大学三谷純准教授が開発した 3D 折り紙ソフトウェアを利用し、ものづくり企業とデザイン関連企業とともに、紙だけでなく多くの素材の可能性を探り、商品パッケージをはじめ新たな商品開発を目指しています。

【内容】

- 筑波大学三谷純准教授による 3D 折り紙の解説
- ソフトウェアのインストール
- ソフトウェアを使ったオリジナルパッケージの試作
- 各自テーマごとに商品開発
- 2010 東京国際包装展併設



Package Design Pavilion に出展

- ・平成 22 年 10 月 5 日(火)～8 日(金) 東京ビッグサイト
- ・3D 折り紙ソフトソフトウェアを使ったパッケージの提案と筑波大学 3D 折り紙ソフトウェアの紹介。

○いばらきデザインフェア 2010 出展

- ・水戸展(茨城県立図書館)：平成 22 年 12 月 14 日(火)～19 日(日)
- ・つくば展(イーアスつくば)：平成 23 年 2 月 5 日(土)～6 日(日)



図 Package Design Pavilion ブース(左)と出品物(右)

【今後の予定】

同業・異業種間で交流しながら、各自テーマごとに 3D 折り紙の可能性を探り、具体的な商品開発の提案を目指します。入会は随時受付けております。

基礎となった事業	平成 22 年度 オンリーワン技術開発支援事業 (研究会)				
担当部門	産業連携室	室長	大力	賢次	tel : 029-293-7212
		主任研究員	寺門	秀人	
		主任研究員	尾形	尚子	
		主任	小林	哲也	
		嘱託	大栗	淳子	
	細技術部門	主任	石川	章弘	